

30.03.2022 – 10:30 Uhr

ERS electronic stellt die nächste Generation des ADM330 mit neuem Design und erweiterten Funktionen vor

Munich, Germany, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -

[ERS electronic](#), der Marktführer im Bereich thermischer Lösungen für die Halbleiterfertigung, enthüllt die Details seines Flaggschiffs der dritten Generation, der thermischen Debond-Maschine [ADM330](#). Die Maschine wurde im Jahr 2007 als erste ihrer Art auf den Markt gebracht. Seitdem hat sie sich zu einem Branchenfavoriten entwickelt und ist in den Produktionsanlagen der meisten Halbleiterhersteller und OSATs im Bereich Advanced Packaging weltweit zu finden.

Anfang dieses Monats wurde das Unternehmen für seine kontinuierliche Innovation und seinen Beitrag zu heterogenen Integrationstechnologien mit dem 3D InCites "Equipment Supplier of the Year"-Award ausgezeichnet.

ERS gewährt nun einen ersten Blick auf die nächste Generation der ADM330, die ihr bisher mattes metallisches Aussehen in eine reine, weiße Oberfläche geändert hat, die zu den meisten Geräten in einem Cleanroom passt. Darüber hinaus ist die Maschine jetzt vollständig konform mit den GEM300 SEMI-Standards, was eine nahtlose Integration in automatisierte Fabs und Industrie 4.0-Architekturen ermöglicht. Die Leistung bei der Warpage-Adjustment wurde ebenfalls verbessert, und zwar dank eines einzigartigen thermischen Chuck-Designs, das eine starke Vakuumleistung ermöglicht, die dreimal besser ist als die des Vorgängers. Schließlich bietet der neue ADM330 eine implementierte Zusatzsoftwarefunktion, die eine eigenständige Lasermarkierung für eine verbesserte Rückverfolgbarkeit von Wafern ermöglicht.

"Wir freuen uns sehr, das neueste Upgrade unseres Flaggschiffs vorstellen zu können. Mit diesen Verbesserungen liefern wir weiterhin ein robustes System, das die sich ständig ändernden Prozessanforderungen des Advanced Packaging erfüllt", sagt **Debbie-Claire Sanchez, FO Equipment Business Unit Manager bei ERS electronic**.

"Es wird erwartet, dass der Wert des Fan-out-Packaging-Marktes bis 2026 mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar erreichen wird, bei einer CAGR von 14 %¹, hauptsächlich getrieben durch 5G-, HPC- und IoT-Anwendungen²", verkündet **Gabriela Pereira, Technology & Market Analyst, Semiconductor, Memory & Computing bei Yole Développement** (Yole). "In diesem dynamischen Kontext ist eine der größten technischen Herausforderungen die Warpage der rekonstituierten Wafer aufgrund von CTE-Abweichungen zwischen den verschiedenen verwendeten Materialien. Die heute von ERS electronic angekündigte nächste Generation der ERS ADM330 Debonding-Maschine wird eine Lösung sein, die eine Verbesserung der Warpage-Adjustment ermöglicht und dazu beiträgt, Ertragsverluste zu reduzieren."

1 Zwischen 2021 und 2026

2 Quelle: Advanced Packaging Quarterly Market Monitor, Q4 2021, Yole Développement (Yole)

Über ERS:

Die ERS electronic GmbH hat sich in der Halbleiterindustrie mit ihren schnellen und präzisen luftkühlungsbasierten thermischen Chuck-Systemen für das Wafer-Probing und ihren thermischen Debonding- und Warpage-Adjustment-Tools für FOWLP/PLP einen hervorragenden Ruf erworben.

www.ers-gmbh.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1776594/ERS_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1776593/ADM330_Gen3.jpg

Pressekontakt:

Sophia Oldeide,
oldeide@ers-gmbh.de,
+49 8989 4132-143

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100089895/100887198> abgerufen werden.